

平成30年 2月 1日

NEDIA会員各位

(一社)日本電子デバイス産業協会

事務局次長 小林関司

材料部品部会主催・第十八回 勉強会開催のご案内

厳寒の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

早速ですが下記の日程で「第十八回 材料部品部会主催の勉強会」を開催いたします。

今回の勉強会では、今後のI・T産業を牽引するカーエレクトロニクス及びロボット産業、並びにこれらの産業を支える重要な電子デバイスについての最新技術情報と今後のマーケット動向について四名の講師の方にお話をさせていただきます。

是非大勢の方のご参加をお待ちしております。

—記—

1. 日時 平成30年 3月14日(水) (13:00~16:10)

2. 場所 御茶ノ水めっきセンター4F会議室

東京都文京区湯島1-11-10

03-3814-5621 (代) <http://www.tmk.or.jp/gaiyou.html>

3. 講演スケジュール

司会 NEDIA 事務局 小林

(1) (13:00~13:50)

テーマ「低温硬化型接着剤の紹介」

講師 安部 信幸 氏 / ナミックス(株) 技術開発本部 技師

(2) (13:50~14:05)

テーマ「金属皮膜ゴムボールによるコネクタの小型・高性能化と常温実装」

講師 瀧澤 明道 氏 / (株)リトルデバイス 代表取締役

(3) (14:05~14:55)

テーマ「サーマルプリンターの最新動向・モバイルフォトプリンターの躍進」

講師 寺尾 博年 氏 / アルプス電気(株) 技術本部 部長

休憩時間 (14:55-15:10)

(4) (15:10~16:10)

講師 南川 明 氏 / IHSグローバル(株) 調査ディレクター

テーマ「I・T普及に必要な5Gインフラ投資」

~~中国の新たな戦略とEVの影響を分析する~~

(注) 添付の用紙に出欠を記入の上、3月 8日までにメールにて事務局宛に返信をお願い致します。

以上